



2023年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年4月13日
上場取引所 東

上場会社名 佐島電機株式会社
 コード番号 7420 URL https://www.satori.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 佐島 浩之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 (氏名) 諏訪原 浩二 (TEL) 03-3451-1040
 四半期報告書提出予定日 2023年4月13日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年5月期第3四半期の連結業績(2022年6月1日~2023年2月28日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年5月期第3四半期	107,492	15.1	3,193	67.4	2,525	18.9	1,787	16.2
2022年5月期第3四半期	93,386	21.6	1,907	338.1	2,124	269.1	1,537	—

(注) 包括利益 2023年5月期第3四半期 2,589百万円(64.4%) 2022年5月期第3四半期 1,575百万円(343.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年5月期第3四半期	108.62	—
2022年5月期第3四半期	93.45	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年5月期第3四半期	78,764	34,567	42.5
2022年5月期	74,492	32,457	43.3

(参考) 自己資本 2023年5月期第3四半期 33,440百万円 2022年5月期 32,240百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年5月期	—	18.00	—	44.00	62.00
2023年5月期	—	26.00	—		
2023年5月期(予想)				44.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2023年5月期の連結業績予想(2022年6月1日~2023年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	147,000	16.8	3,700	42.2	3,000	15.3	2,300	20.5
								139.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 1社(社名) SM Electronic Technologies Pvt. Ltd.、除外 1社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年5月期3Q	17,946,826株	2022年5月期	17,946,826株
② 期末自己株式数	2023年5月期3Q	1,492,375株	2022年5月期	1,492,158株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2023年5月期3Q	16,454,574株	2022年5月期3Q	16,454,822株

(注) 期末自己株式数には、株式報酬制度に関連して信託が保有する当社株式(2023年5月期3Q 505,100株)が含まれております。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(2023年5月期3Q 505,100株)。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(企業結合等関係)	10
(重要な後発事象)	11
3. その他	12
(1) 製品及びサービスごとの情報	12
(2) 地域別売上高	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的に行動制限緩和が継続、中国ではゼロコロナ政策を解除する一方、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、世界的なインフレによる各国の金融政策引き締めなど不安定な状況が続いています。

このような環境の中、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は車載向け外資系半導体と調達マネジメントサービスの好調に加え、円安の影響等もあり、1,074億92百万円（前年同期比15.1%増）となりました。利益面につきましては、営業利益は主に販売費及び一般管理費の増加はあったものの、売上増等に伴う売上総利益の増加により31億93百万円（前年同期比67.4%増）、経常利益は支払利息、債権売却損の増加はあったものの、営業利益の増加により25億25百万円（前年同期比18.9%増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は17億87百万円（前年同期比16.2%増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第3四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

①産業インフラ事業

インダストリアルソリューション事業本部の半導体製造装置用制御機器の売上増等により、売上高は223億2百万円（前年同期比7.3%増）、セグメント利益は9億94百万円（前年同期比38.7%増）となりました。

②エンタープライズ事業

調達マネジメント事業本部の売上増および円安の影響により、売上高は385億58百万円（前年同期比22.5%増）、セグメント利益は19億7百万円（前年同期比118.1%増）となりました。

③モビリティ事業

当社の子会社であるスター・エレクトロニクスの売上増により、売上高は98億99百万円（前年同期比28.0%増）、セグメント利益は8億72百万円（前年同期比69.2%増）となりました。

④グローバル事業

PC需要減に伴う電子部品の減少に対し、事務機器用ユニット製品の売上増により、売上高は367億32百万円（前年同期比10.0%増）、セグメント利益は2億96百万円（前年同期比34.1%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、787億64百万円（前連結会計年度末744億92百万円）となり、42億71百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加（15億49百万円）、商品及び製品の増加（44億59百万円）によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における負債は、441億96百万円（前連結会計年度末420億35百万円）となり、21億61百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（57億19百万円）はあったものの、短期借入金の増加（59億21百万円）によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、345億67百万円（前連結会計年度末324億57百万円）となり、21億10百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加（6億22百万円）、為替換算調整勘定の増加（5億97百万円）、非支配株主持分の増加（9億10百万円）によるものであります。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の43.3%から42.5%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2023年1月13日の「2023年5月期 第2四半期（累計）連結業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

また、配当につきましては、当期の業績見込、財政状態、配当性向等を総合的に勘案し、2022年7月14日公表の配当予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日公表いたしました、「2023年5月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,996	7,863
受取手形及び売掛金	32,719	34,268
商品及び製品	18,646	23,105
仕掛品	240	547
原材料及び貯蔵品	854	646
その他	4,897	3,055
貸倒引当金	△7	△9
流動資産合計	65,347	69,477
固定資産		
有形固定資産	3,123	3,347
無形固定資産		
のれん	—	270
その他	1,170	985
無形固定資産合計	1,170	1,255
投資その他の資産		
その他	5,381	5,246
貸倒引当金	△530	△562
投資その他の資産合計	4,851	4,683
固定資産合計	9,145	9,286
資産合計	74,492	78,764
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	22,922	17,202
短期借入金	5,567	11,489
未払法人税等	438	429
その他	7,042	8,856
流動負債合計	35,971	37,978
固定負債		
社債	1,400	1,400
長期借入金	2,800	2,837
退職給付に係る負債	1,389	1,423
その他	474	557
固定負債合計	6,063	6,218
負債合計	42,035	44,196

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,558	3,447
利益剰余金	25,229	25,852
自己株式	△1,725	△1,761
株主資本合計	29,674	30,149
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,433	1,598
繰延ヘッジ損益	△0	△37
土地再評価差額金	22	22
為替換算調整勘定	1,110	1,707
その他の包括利益累計額合計	2,566	3,291
非支配株主持分	216	1,127
純資産合計	32,457	34,567
負債純資産合計	74,492	78,764

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2021年6月1日 至2022年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自2022年6月1日 至2023年2月28日)
売上高	93,386	107,492
売上原価	84,935	97,395
売上総利益	8,451	10,096
販売費及び一般管理費	6,543	6,903
営業利益	1,907	3,193
営業外収益		
受取利息	1	5
受取配当金	64	90
受取補償金	325	174
その他	75	84
営業外収益合計	467	354
営業外費用		
支払利息	59	181
債権売却損	24	383
為替差損	123	373
その他	42	82
営業外費用合計	250	1,021
経常利益	2,124	2,525
特別損失		
段階取得に係る差損	—	77
固定資産除却損	4	13
特別損失合計	4	90
税金等調整前四半期純利益	2,120	2,434
法人税、住民税及び事業税	332	526
法人税等調整額	202	43
法人税等合計	534	570
四半期純利益	1,585	1,864
非支配株主に帰属する四半期純利益	47	77
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,537	1,787

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
四半期純利益	1,585	1,864
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△353	164
繰延ヘッジ損益	0	△37
為替換算調整勘定	343	597
持分法適用会社に対する持分相当額	—	△0
その他の包括利益合計	△9	725
四半期包括利益	1,575	2,589
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,528	2,518
非支配株主に係る四半期包括利益	47	70

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期 連結損益 計算書計上 額 (注) 2
	産業 インフラ 事業	エンター プライズ 事業	モビリティ 事業	グローバル 事業	計		
売上高							
顧客との契約から生じる 収益	20,778	31,465	7,736	33,406	93,386	—	93,386
外部顧客への売上高	20,778	31,465	7,736	33,406	93,386	—	93,386
セグメント間の内部売上高 又は振替高	179	3,460	2,414	162	6,217	△6,217	—
計	20,957	34,926	10,150	33,569	99,604	△6,217	93,386
セグメント利益	716	874	515	450	2,557	△649	1,907

(注) 1. セグメント利益の調整額△649百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期 連結損益 計算書計上 額 (注) 2
	産業 インフラ 事業	エンター プライズ 事業	モビリティ 事業	グローバル 事業	計		
売上高							
顧客との契約から生じる 収益	22,302	38,558	9,899	36,732	107,492	—	107,492
外部顧客への売上高	22,302	38,558	9,899	36,732	107,492	—	107,492
セグメント間の内部売上高 又は振替高	202	4,130	2,505	80	6,919	△6,919	—
計	22,504	42,689	12,404	36,813	114,411	△6,919	107,492
セグメント利益	994	1,907	872	296	4,071	△877	3,193

(注) 1. セグメント利益の調整額△877百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、デバイスソリューションとシステムソリューションの二つの事業を両輪として経営を推進してまいりましたが、組織変更に伴い、第1四半期連結会計期間より、市場領域別にセグメントを変更することといたしました。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成しております。

それぞれの報告セグメントの内容は次のとおりです。

(1) 産業インフラ事業

主に産業、社会インフラ向けシステムソリューションの開発／販売、通信用部品、電子機器の販売を行っております。

(2) エンタープライズ事業

主に国内向け半導体、電子部品の販売、調達マネジメントサービス、スイッチ製品の開発／販売、ソリューションの提供を行っております。

(3) モビリティ事業

主に車載向け半導体、電子機器の販売、ソリューションの提供を行っております。

(4) グローバル事業

主に海外向け半導体、電子部品の販売、ソリューションの提供を行っております。

(5) 全社及び消去

主にビジネス・デベロップメント機能およびコーポレートスタッフ機能となります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

当第3四半期連結会計期間に持分法適用関連会社であったSM Electronic Technologies Pvt. Ltd. の株式を追加取得し、当社の連結子会社となったことから、モビリティ事業において、のれん270百万円を計上しております。

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

当社は、当社の持分法適用関連会社であったSM Electronic Technologies Pvt. Ltd. (以下「SMエレクトロニクス社」という。) について、2023年2月28日付で株式を追加取得し、同社を連結子会社(50.1%)といたしました。

また、同社株式を追加取得するにあたり、その一部は当社の連結子会社であったSINGAPORE SATORI PTE., LTD. (現 SMET SINGAPORE PTE. LTD.) (以下「SG社」という。) の株式を現物出資したことにより、SG社はSMエレクトロニクス社の100%子会社(当社連結孫会社)となりました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称	SM Electronic Technologies Pvt. Ltd.
事業の内容	電子部品卸販売

(2) 企業結合を行った主な理由

当社は、2022年4月13日付でSMエレクトロニクス社の株式(発行済株式総数に対する割合25.1%)を取得し、当社の関連会社(持分法適用会社)とし、当社が保有する開発ノウハウや取り扱い製品の展開を行いながら、SMエレクトロニクス社を通じ、インドローカル企業への半導体製品などの営業活動を行っております。

インド市場は今後も成長が見込まれる魅力的な市場であることに加え、当社が同国市場に更なる飛躍を実現できる可能性を踏まえ、また、連結子会社化することで当社の企業価値増大を図ることを目的に同社の株式取得(子会社化)に至りました。

- (3) 企業結合日
みなし取得日 2022年12月31日
- (4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得及び現物出資（S G社株式）による株式取得
- (5) 結合後企業の名称
変更はありません。
- (6) 取得した議決権比率
- | | |
|--------------------|-------|
| 企業結合直前に所有していた議決権比率 | 25.1% |
| 企業結合日に追加取得した議決権比率 | 25.0% |
| 取得後の議決権比率 | 50.1% |
- (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社がSMエレクトロニクス社の株式を取得し議決権の50.1%を取得したことによるものであります。

2. 四半期連結財務諸表に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2022年12月31日をみなし取得日としており、かつ、四半期連結決算日との差異が3ヶ月を超えないことから、当第3四半期連結会計期間においては貸借対照表のみを連結しております。

なお、当第3四半期連結累計期間の業績については、当四半期連結損益計算書に営業外費用（その他）として計上しております。

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得価額につきましては、相手先との基本合意上の守秘義務契約に基づき非開示とさせていただきます。

なお、第三者機関による適切なデューデリジェンスを実施し、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを実施しております。

4. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損 77百万円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの額

270百万円

(2) 発生原因

今後の事業活動によって期待される将来の超過収益から発生したものです。

(3) 償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)

(単位：百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	33,144	39,706	15,939	4,596	93,386

当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位：百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	42,420	40,342	21,028	3,701	107,492

(2) 地域別売上高

前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)

(単位：百万円)

日本	海外						合計
	中国	台湾	タイ	その他アジア	その他	計	
42,826	32,192	2,433	5,702	5,403	4,827	50,560	93,386

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位：百万円)

日本	海外						合計
	中国	台湾	タイ	その他アジア	その他	計	
51,269	33,046	1,337	8,818	7,622	5,398	56,223	107,492

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。